

Leiterplattenfertigungsanlagen up to date

Traditionell innovativ

Eine selektierte Modulauswahl in Bezug auf Technologie und Design demonstriert, was in der modernen Leiterplattenfertigung up to date sein sollte.

Das Premium Line-Konzept von Gebr. Schmid steht für verbesserte Prozessstabilität und optimierten Transport dünnerer Materialien. Durch den Gebrauch von tiefgezogenen Wannen ohne Schweißnähte ist die Möglichkeit für eine schnelle, rückstandsfreie Entleerung und problemlose Modulreinigung gegeben.

- ▶ Beim Ätzmodul präzisieren ein verbesserter Düsenstock für höhere Ätzfaktoren und ein gleichmäßiges Ergebnis das Verfahren.
- ▶ Das Bimsmehl-Sprühmodul hat ein komplettes Re-Design und Detailoptimierungen erfahren. Novum an diesem Punkt ist das Transportsystem für Leiterplatten ab 0,1 mm Stärke.
- ▶ Für das Entwickeln mit kontaktfreiem Transportsystem wird demnächst ein Modul im Premium Line-Design gefertigt.
- ▶ Auch das Desmear wurde in das Premium Line-Konzept aufgenommen. Dabei zu erwähnen ist das Transportsystem für flexible Leiterplatten und das Vorschubsystem, optimiert für eine Foliendicke von 25 µm.

Das Chemisch-Kupfer-Standardmodul ist durch technologische Modifizierungen auf den aktuellsten Stand gebracht.

Des Weiteren präsentiert Schmid ein Beispiel für ein Kupfer-Recycling-System für alkalisches Ätzen.

Vom Tochterunternehmen Schmid Technology Systems GmbH in Niedereschach werden innovative Automations-Systeme zur Oberflächen-Behandlung, Oberflächen-Inspektion und Produktionsfluss vorgestellt.

Automation weit gefasst

Die Schmid-Be- und Entladungssysteme (Bild 1) sind durch ein kompaktes Design gekennzeichnet. Der Einsatz von moderner Ro-



Bild 1: Be- und Entladungssystem SU217-P von Gebr. Schmid

botronik und optimierter Handlings-Technologie die höchste Ansprüche erfüllt, ermöglicht ein ordentliches Preis-Leistungsverhältnis.

Das Handlingsystem Flex Picker (Bild 2) arbeitet mit minimalem Substratkontakt. Der Einsatz dieses Hochleistungs-Robo-



Bild 2: Das Handlingsystem Flex Picker


ters ermöglicht in Kombination mit dem Schmid Vision-System kurze Taktzeiten und höchste Flexibilität.

Nahezu alle Materialien wie Kunststoffe, Glas, Metalle, Lamine und Polymere mit einer Stärke von 50 µm bis 8 mm können mit dem Inline-Plasma-Bearbeitungssystem für eine hoch effiziente Oberflächenreinigung aktiviert werden. Die Anlage kann Inline oder auch stand alone betrieben werden.

Durch Einsatz einer automatischen Leiterplatten-Endkontrolle lassen sich Kosten senken und die Qualität steigern. Oberflächenfehler jeglicher Art können manuell oder vollautomatisch durch dieses Inspektions-

onssystem ermittelt werden.

Die Schwetzingen Niederlassung Schmid Technology GmbH stellt zudem zwei Inkjet-Anlagen vor. Die neue Version DoD8000 birgt einen hohen Grad an technischer Innovation in sich, um künftigen Anforderungen gerecht zu werden. Durch modulare und offene Interface-Gestaltung kann jeder industriefähige Druckkopf eingesetzt werden. Mit seiner Entwicklung auf dem modernsten Stand der Technik entspricht die Anlage den höchsten Anforderungen bezüglich Genauigkeit der Bildplatzierung und Registrierungstoleranzen, ohne dabei Kompromisse bei Produktionsdurchsatz und Bedienerfreundlichkeit eingehen zu müssen. (hb)

	Gebr. Schmid	Kennziffer 407
Fax +49/74 41/53 81 21 www.schmid-online.de		